



TG-ASD35AB 導熱凝膠

Thermally Conductive Gel

REACH Compliant | RoHS Compliant | UL Comparable

產品特性 Features

- 優異導熱性能
Good thermal conductivity
- 可搭配擠出槍方便作業，容易施工
Thermal gel gun friendly & easy assembly
- 一比一比例混合
A:B=1:1
- 室溫或加熱熱化
Cures at room temperature or with heat

產品應用端 Applications

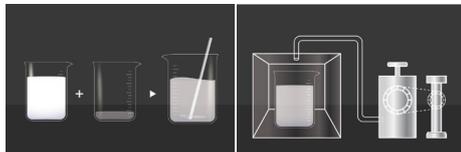
電子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

保存方式 Storage

導熱凝膠其在未開封之狀態，在室溫 25°C 以下可保存 12 個月。
Thermally Conductive Gel has a shelf-life of 12 months from the date of manufacture, as indicated by the lot number, when stored in the original, should be unopened container at or below 25°C.

操作說明 Operation Manual

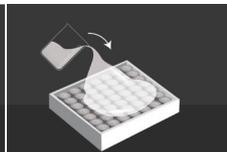
罐裝 Pot



① Mix component A and B.

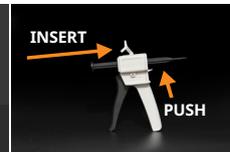


② Vacuum out air.



③ Pour potting compound.

雙劑管 Tube



① Push the latch and insert the stick.



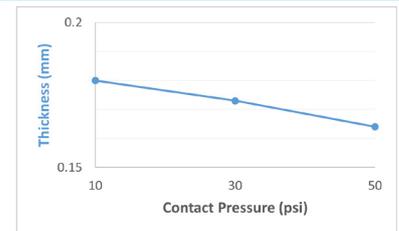
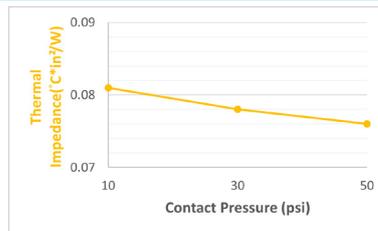
② Put the tube in.



③ Close the cover.

產品物性 Properties

混合固化壓力，熱阻抗，厚度示意圖 Curing Contact Pressure, Thermal Impedance, and Thickness



Properties	Unit	TG-ASD35AB	Tolerance	Test Method
導熱係數 Thermal Conductivity	W/m·K	3.5	±0.5	ISO 22007-2
顏色 Color	-	A: 粉紅 Pink / B: 白 White	-	ASTM D2244
耐電壓 Dielectric Breakdown Voltage	kV/mm	7	±3	ASTM D149
體積阻抗 Volume Resistivity	Ohm·m	10 ¹⁴	10 ¹³ ~10 ¹⁵	ASTMD257
密度 Density	g/cm ³	3	±0.15	ASTM D792
操作溫度 Operating Temperature	°C	-50~+150	-	-
重量損失 Weight Loss	%	<1	-	By T-Global
黏度 Viscosity @1.0rpm	Pa·s	A:250 / B:250	±100	ASTM D7395 ASTM D4287
延伸率 Elongation	%	>100	-	ASTM D412
抗拉強度 Tensile Strength @T3.0mm	kgf/cm ²	10	-	ASTM D412
固化時間 Curing Time @25° C	Min	120~240	-	-
固化時間 Curing Time @50° C	Min	20~40	-	-
固化時間 Curing Time @80° C	Min	15~20	-	-
標準規格 Standard Package	-	罐裝 Pot / 雙劑管 Tube	-	-
混合比例 Mixing Ratio	-	1:1	-	-
硬度 Hardness	Shore OO	40	±10	ASTM D2240

▶ A 劑與 B 劑皆為混合材料，因密度不同會造成沉澱分層，屬正常現象，使用前請用扁平刮刀或是其他不鏽鋼工具，分別均勻攪拌兩劑再混和，以獲得最好的導熱效果。
Component A & Component B are mixed material. It is normal to cause precipitation and stratification due to different density. Well mixed component A before use by a flat spatula or other stainless tools to achieve the ideal thermal conductivity.

高柏科技股份有限公司 T-Global Techonology Co., Ltd.

330058 桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No. 33, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version 21
20260127



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。